

문서번호: 제2018-01-01호

수 신:

참 조:

발 신: 테크포럼(주)

제 목: '카메라모듈 부품/센서 응용분야별 기술 및 최신동향 세미나' 안내

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 테크포럼은 1월 24일(수) 오전 10시에 한국기술센터 16층 국제회의실에서 '카메라모듈 부품/센서 응용분야별 기술 및 최신동향 세미나' 를 개최합니다.
3. 본 세미나에 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

- 아 래 -

가. 행사명: 카메라모듈 부품/센서 응용분야별 기술 및 최신동향 세미나

나. 일시: 2018년 1월 24일(수) 10시~17시

다. 장소: 한국기술센터 16층 국제회의장

라. 주최/주관: 테크포럼

마. 세부일정

시간	주제
10:00~10:50 [트랙1]	2018년 카메라모듈 시장전망
11:00~11:50 [트랙2]	카메라모듈 센서/부품 분야별 연구, 기술 및 최신 동향
12:00~12:50 [트랙3]	인공지능 기반 차세대 이동체를 위한 카메라 기반 영상 인식 기술
14:00~14:50 [트랙4]	고해상도 이미지 구현을 위한 픽셀 기술 동향 및 전망
15:00~15:50 [트랙5]	차세대 CMOS Image Sensor용 OPD (Organic Photodiode) 기술개발 동향
16:00~16:50 [트랙6]	카메라/이미지 기반 VR/AR 기술 및 사용자 인터랙션 응용

※ 발표 주제 및 일정은 연사/주최측의 사정에 의해 공지 없이 변경될 수 있습니다.

바. 등록비

A. 사전결제: 253,000원(부가세/중식/자료집/PDF 포함) - 1월 23일(화) 18시까지

B. 현장결제: 275,000원(부가세/중식/자료집/PDF 포함)

테 크 포 럼 (주)

